

半導体ウエハ業界 世界

ダウンロード

- 世界
- CHN
- TWN
- MYS
- USA

調査担当：Uzabase/ハイテク・資本財セクターチーム 最終更新日：2024年12月03日（最終訂正日：2024年12月03日）グラフは自動更新されます

業界基本情報

業界定義	半導体に使われるウエハを製造する企業群。ウエハの原料となる多結晶シリコン、太陽電池に用いられるインゴッドをスライスした多結晶もしくは単結晶ウエハを製造する企業は除く
関連業界	半導体（メモリ）、半導体（ロジック）、半導体（ディスクリート）、半導体（パワー）、半導体（ファブレス）、半導体テスト・後工程受託
関連トレンド	-
関連業界団体等	、半導体産業研究所、新金属協会、日本電子デバイス産業協会 (NEDIA)、電子情報技術産業協会 (JEITA)

最新M&A案件 [全ての業界M&A案件情報を見る](#)

 Blackrock Investment Management decreases Soitec short position	
少数持分取得 - 取得価格 497 百万円	公表 - 2025/05/28
 Blackrock Investment Management increases Soitec short position	
少数持分取得 - 取得価格 250 百万円	公表 - 2025/05/21
 Nomura International sells stake in Sumco	
少数持分取得 - 取得価格 5,749 百万円	公表 - 2025/05/15
 Nomura Asset Management acquires stake in Sumco	
少数持分取得 - 取得価格 3,190 百万円	公表 - 2025/05/15
 Nomura Securities sells stake in Sumco	
少数持分取得 - 取得価格 2,208 百万円	公表 - 2025/05/15

最新ニュース [全ての業界ニュースを見る](#)

SUMCO(3436.T) [【四季報先取り】SUMCO](#)

日経平均は265円程度安、採用銘柄の値下がり率上位はベイカレント、SUMCO、安川電など

[雲抜け銘柄一覧／一目均衡表・雲抜け銘柄一覧](#) 2025/06/12 07:42:51

[サムコ、3Q営業利益 7.9%増 13.93億円／決算チェック](#) 2025/06/12 06:08:34

テクニカルで選ぶ注目銘柄＝SUMCO：5日線と25日線のミニGCを形成、日足一目均衡表の上限も突破

レポートサマリー

業界概要

- ・半導体デバイスに不可欠なシリコンウエハは、メモリ市場の影響を大きく受ける
- ・メモリICに支えられる300mmウエハが販売の主流
- ・単結晶シリコンの製造には、生産効率の高いCZ法が選好される
- ・微細化の流れはウエハの歩留まりに影響を及ぼす可能性も、欠陥検出感度の低下や熱管理の難しさなどが課題に

市場環境

- ・5GやHBM機器への需要増がシリコンウエハ市場の追い風に
- ・ウエハ生産量では日本がトップ、ファウンドリ部門とパッケージング・検査部門では台湾がリード
- ・パワー半導体のエネルギー効率を向上させる、シリコン代替のウエハ材料

競争環境

- ・大手5社が寡占市場を形成
- ・主要企業は「グリーンフィールド戦略」による生産能力拡大を推進
- ・信越半導体、SUMCOは技術的競争力が高い
- ・GlobalWafersは無機成長によりSOIウエハ市場でのプレゼンス確立を図る
- ・ビッグ5の業績は悪化している

業界概要

半導体デバイスに不可欠なシリコンウエハは、メモリ市場の影響を大きく受ける

国際的な半導体業界団体である国際半導体製造装置材料協会（SEMI）によると、2023年の世界のウエハ製造用材料市場の売上高は約420億ドルにのぼる。うち、シリコンウエハは全体の約30%と最大割合を占めた。シリコンウエハとは、集積回路（IC）に使われる半導体材料の基板や薄片をさす。

シリコンは最も広く使用されている費用対効果の高いウエハ材料であるが、優れた導電性をもつ炭化ケイ素（SiC）や窒化ガリウム（GaN）などのワイドバンドギャップ半導体向けの需要も高まっている。

SEMIによると、ウエハ出荷面積は2024年に減少したのち、2025年にはAIや高度処理向けの需要拡大、先進パッケージングや高域幅メモリ（HBM）など新技術の普及拡大に下支えされ回復する見通しである。

メモリICに支えられる300mmウエハが販売の主流

ウエハは、直径（ミリメートル、mm）によってその表面積が定まり、ウエハあたりに形成されるダイ数が決まる。つまり、ウエハの直径に比例してダイ数が増加すると、生産性が向上し単位あたりコストが下がることを意味する。

ウエハの直径はさまざまで、300mm、200mm、150mm以下に大別される。各直径のウエハには、その機能に基づき異なる製品セグメントからの需要がある。Pulse（テクノロジー業界調査会社Omdiaに基づく）によると、300mmウエハは2021年時点で世界のシリコンウエハ市場売上高の約72%を占めるものの、200mmウエハにも依然として主流のエレクトロニクス製品向けとして大きな需要がある（入手可能な最新データ）。

300mmウエハは先端ノードでの量産チップ（DRAMやNANDフラッシュメモリ）に適しており、200mmは産業・車載用途（アナログ・高周波デバイス）向けの比較的成熟したノードを対象としている。半導体市場調査会社のIC Insightsによると、DRAM・NANDフラッシュメモリの大手サプライヤー[Samsung Electronics](#)（KOR）、[Micron Technology](#)（USA）および[SK Hynix](#)（KOR）は、2020年時点で世界の300mmウエハ月産能力の約5割を占める（入手可能な最新データ）。

単結晶シリコンの製造には、生産効率の高いCZ法が選好される

ウエハ生産はまず、純度が極めて高いシリコンであるポリシリコン

また、一般的に長期契約を結ぶ顧客がシリコンウエハの種類やサイ

を調達することから始まる。調達は、不測の事態の際もサプライチェーンへの影響を最小限に抑えられるよう本業界の主要企業が長期供給契約を結んでいる外部供給業者から行う。シリコン以外にも、SiC、GaN、GaAsなどの化合物半導体を使用するウエハもあるが、これらの材料は高価かつ製造が難しく、ウエハ製造に利用するには制限がある。

高い純度が要求されるウエハは、わずかな汚染があっただけでも半導体製品機能に影響が及ぶため、特別なクリーンルームで生産される。ウエハ製造では、単結晶シリコンが非常に重要である。これは、純度や均一性といった材料パラメータに優れており、ウエハ製造に適しているためである。

本業界では、単結晶シリコンの製造方法として、低コスト、高熱耐性、高速生産が可能なCZ法（Czochralski法）が選好される。ただ、この方法ではるつぼを使用するため、不純物が多くなるという欠点がある。石英るつぼは製造工程において徐々に溶解し、熔融シリコンに大量の酸素を放出してしまう。そのため近年ではるつぼの代わりに、不活性ガス雰囲気中で製造するFZ法（Float Zone法）などの高純度法が普及しつつある。

CZ法を使用したシリコンウエハ製造

ズを指定する。シリコンウエハの主要顧客は、垂直統合型デバイスメーカー（IDM）やファウンドリなどのチップメーカーである。これらのチップメーカーは独自の製造施設（一般にファブと呼ばれる）を保有し、そこで多面的な工程を踏んでウエハはロジックIC・メモリICへと加工される。これらのファブは、扱うウエハのサイズにより分類される。これは、ウエハのサイズにより必要な製造技術や設備が異なるためである。

シリコンウエハの種類

種類	ポリッシュト・ウエハ	エピタキシャル・ウエハ	アニール・ウエハ	SOIウエハ
直径	100mm、125mm、150mm、200mm、300mm	100mm、125mm、150mm、200mm、300mm	150mm、200mm、300mm	150mm、200mm
工程	平坦で清浄な表面をもつ超高純度基板	ポリッシュト・ウエハの表面に、単結晶シリコン層をエピタキシャル成長させる	ポリッシュト・ウエハを炉の中で所定の温度に加熱する	薄い絶縁層を2枚のポリッシュト・ウエハ間に挟み込み結合させる
用途	DRAM、	マイクロプロ	DRAM、	パワーデバイ

単結晶の成長	石英るつぼの中で多結晶シリコンを溶かし、その中で種結晶を回転させながら引っ張り、溶融シリコンを固化させてシリコン結晶インゴットを取り出す。結晶を引き上げる速度や温度は、ウエハサイズにより異なる
ドーピング	エンドユーザーの用途により、半導体の導電性を変える目的でインゴットの成長段階で不純物（ドーパント）を添加
切断	シリコンインゴットを、ダイヤモンドソーなどで均一な厚さの非常に薄いウエハにスライス
粗研磨	ウエハの表面を粗研磨（ラッピング）し、表面層について切断工程で生じたダメージを除去
エッチング	切断工程・粗研磨工程で生じたウエハ表面上のダメージを除去するため、化学的に活性な試薬でウエハをエッチング
研磨	ウエハの表面が極限まで平坦になるよう、化学的・機械的に研磨
検査	ウエハの表面欠陥や均一な平坦度を専用の技術で綿密に検査
出荷	包装し、ポリッシュドウエハとしてファブに出荷。もしくは、さらに特殊加工を加えたウエハ（エピタキシャル・ウエハ、アニール・ウエハ、SOIウエハなど）を製造

NANDフラッシュメモリ

セッサ、イメージセンサ、パワーデバイス

NANDフラッシュメモリ、SRAM、M/ROM

ス、高周波デバイス

出所：Uzabase作成
注：一例を示す

出所：Uzabase作成

半導体ウエハ業界のバリューチェーン

企業、業界、M&A、開示資料、ニュース、レポート、IR・統計、トレンド、特許、FLASH Opinionを検索

チケット残数
5.00枚

業界を探す

業界概要

プレイヤー一覧

プレイヤー散布図

スタートアップ

ニュース

M&A

統計

IRデータ

レポート

業界指数

メニューを閉じる



出所：Uzabase作成

微細化の流れはウエハの歩留まりに影響を及ぼす可能性も、欠陥検出感度の低下や熱管理の難しさなどが課題に

半導体製造では、微細化が進むことで1枚のウエハに積載できるコンポーネントの数が増え、正常に機能するチップ総数を増やすことができる。ただ、これと同時にウエハの歩留まりや全体的な生産効率に影響を及ぼす欠陥検出感度に課題が生じるようになった。また、不純物や微小なごみがあるだけで複数のトランジスタや回路の機能に影響が及び、結果としてディフェクト（異物やキズ、ピットなど）が生じる可能性がある。このようなディフェクトがあると、ウエハ上のダイが正常に作動しない可能性があり、歩留まりに直接影響を及ぼす。

微細化には、ウエハ上に精密にパターンを描く極端紫外線（EUV）リソグラフィなどの先進技術が必要不可欠である。これらのツールは複雑かつ繊細であるため、わずかな誤差が生じただけでも要求精度に影響を及ぼし、ディフェクトが生じたり歩留まりが低下したりする可能性がある。加えて、各コンポーネントが微細化することで、電流が集中・高密度化するようになり熱が発生しやすくなるため、熱管理の

歩留まりを維持するにはそれを正確に測定することも重要である。歩留まりの測定には、ウエハの質とアラインメントを高度な測定ツールを用いてモニタリングする必要がある。ディフェクトを早期に検出しそれを修正することで、リソグラフィやエッチングなど、後に続くよりコストがかかる工程で不具合が生じるのを防ぐことができる。また、ウエハのノードが微細化することで、専門設備・工程への投資が必要となるため、技術的な複雑さが高まり関連コストが増大する。後期工程に進むほど欠陥に対する許容度が低下しコストも増大することから、高い歩留まりを維持することが非常に重要となる。

難易度が増している。特に3次元積層構造では、過度の熱が生じると、時と共にコンポーネントの機能の安定性が低下し、歩留まりや機能性の両方に影響が及ぶ可能性がある。

市場環境

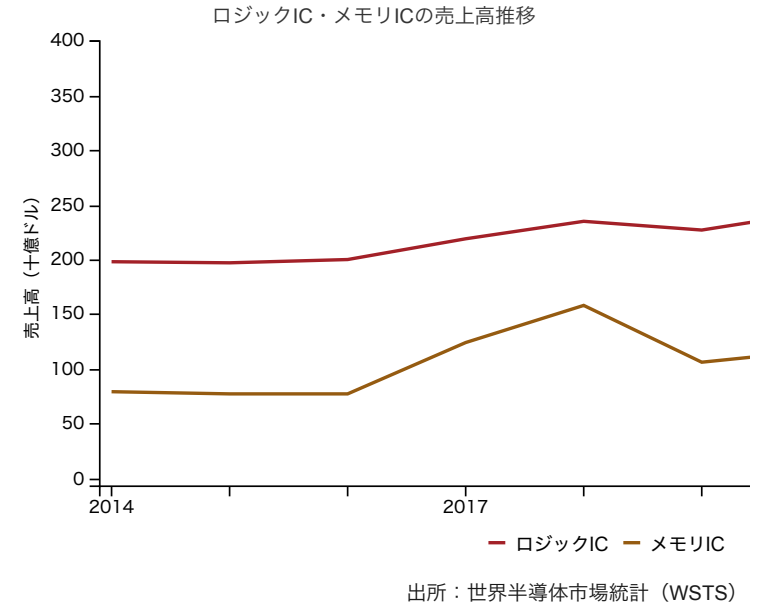
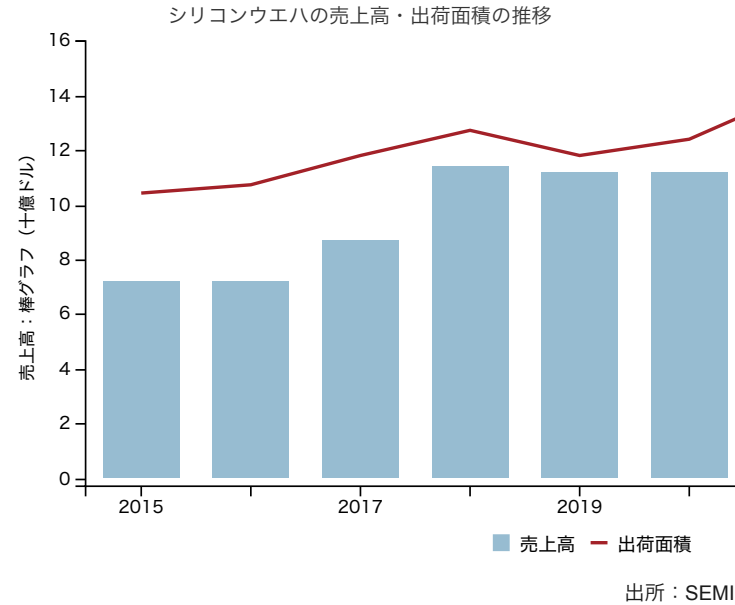
5GやHBM機器への需要増がシリコンウエハ市場の追い風に

シリコンウエハ売上高は2023年に前年比約11%減となった。これは、最終市場での需要減と在庫調整を主因にウエハ出荷面積が前年比約14%減となったことによる。メモリIC・ロジックICの需要が軟化し、受注量が落ち込んだことから、ファウンドリ・アナログ市場での生産活動が低迷した。このことが、ウエハ出荷面積減少の要因となった。世界のメモリIC売上高は2023年に前年比約29%減、ロジックIC売上高は同約2%減となった。

これに先立ち、2016-18年にかけてシリコンウエハ売上高は年平均成長率（CAGR）約26%と過去最高の成長率を示した。これは、半導体メモリ市場が成長したこと（同期間でCAGR約43%）を反映している。続く、2019年にはシリコンウエハの売上高および出荷面積は減少した（それぞれ前年比2%減、同7%減）。これは、供給過剰による価格環境の悪化により、メモリ市場が低迷（前年比33%減）したことによる。また、米中貿易摩擦の影響により半導体市場全体が低迷したことも一因である。ただ、こうした影響は、先端ノードへの投資を行う顧客からの需要増により、同年のロジックIC売上高の減少が前年比3%減とかなり低く抑えられたため一部相殺された。

その影響も束の間、コロナ禍となった2020年には、ウエハ出荷面積は、リモートワークの普及を背景にPC・タブレット端末などのデジタル機器やデータセンターなどの需要に支えられ、前年比5%増と回復傾向となった。一方、売上高はシリコンウエハの価格が軟調に推移したため、通年で横ばいに推移した。2020-22年にかけて、シリコンウエハの売上高および出荷面積はそれぞれCAGR約11%と約8%で顕著な伸びを示した。主に自動車、産業、IoTの各部門における旺盛な需要や5Gの普及拡大がこの成長を下支えした。

SEMIによると、ウエハ出荷面積は2024年に前年比約2%減少したのち、2025年にはAIや高度処理向けの需要拡大、先進パッケージングや高域幅メモリ（HBM）など新技術の普及拡大に下支えされ前年比約10%回復する見通しである。



ウエハ生産量では日本がトップ、ファウンドリ部門とパッケージング・検査部門では台湾がリード

米ジョージタウン大学の政策研究機関、安全保障・先端技術研究センター（Center for Security and Emerging Technology）によると、日本は2023年9月時点で世界の半導体材料市場の約48%を占めた。日本には、世界のシリコンウエハメーカー上位2社が本社を置き、ウエハ生産量でトップとなっている。ウエハ製造に不可欠な高レベルの高純度化・精密技術においても高い競争力をもつ。また、結晶加工やウエハ処理ツールでも高い評価を得ている。

駐シンガポール台北代表處によると、半導体メーカーはアジアに集中しているものの、米国政府が米中貿易摩擦の激化を背景にCHIPS法や科学法を導入したことで、中国国内外の企業の製造活動・投資意欲が減退し、この構造に変化が生じている。一方、他の国々はサプライチェーンを確保し、市場で中国にとって代わる地位を確立しようと、補助金やインセンティブの提供やイノベーション創出を支援することで国内半導体産業の生産能力拡大に努めている。なお、台湾は2023年時点でファウンドリ部門とパッケージング・検査部門で世界首位、設計部門で世界2位につき、引き続き市場で確固たる地位を維持している。

パワー半導体のエネルギー効率を向上させる、シリコン代替のウエハ材料

市場調査会社Mordor Intelligenceによると、SiCシリコンウエハ市場売上高は2024-29年にかけてCAGR約25%で成長し20億ドル超となると予測される。シリコンウエハは半導体製品の基板として最も広く使用されているが、特に太陽電池、電気自動車（EV）、産業用電源などにおける低出力～高出力までの用途で物理的な限界に近づきつつある。このため、従来のシリコンに比べて省エネを実現でき、高スイッチング周波数、高耐電圧性、高耐熱性をもつSiCやGaNなどが代替ウエハ材として検討されている。

ただ、SiCウエハは依然として定着しておらず、市場浸透率も比較的低い。その要因として、製造工程が長くコストが高いことが挙げられる。たとえば、SiCインゴットの成長にはシリコンの2倍高温にした炉で数週間がかかり、1つのインゴットから製造できるのは50枚程度にすぎない。一方、価格はシリコンの20~50倍にのぼる。また、SiCウエハはシリコンウエハに比べて製品サイズが小さいため、SiCベース半導体の生産効率は制限される。

競争環境

大手5社が寡占市場を形成

シリコンウエハの主要メーカーとしては、[信越半導体](#)、[SUMCO](#)、[GlobalWafers](#)（環球晶圓、TWN）、[Siltronic](#)（DEU）および[SK Siltron](#)（KOR）が挙げられ、ビッグ5と呼ばれている。

業界が寡占的である理由は、参入障壁が高いことにある。これは、資本集約的な性質と、高いレベルの高純度化・加工技術が必要とされることが主因である。

ウエハ業界の主要企業（2023年度）

企業	国・地域	売上高（億ドル）	シリコンウエハ種類	製造拠点所在地
信越半導体	日本	35**	ポリッシュト・ウエハ、エピタキシャル・ウエハ、SOIウエハ、アニール・ウエハ	日本、米国、英国、マレーシア、台湾
SUMCO	日本	30	ポリッシュト・ウエハ、エピタキシャル・ウエハ、SOIウエハ、JIW***、アニール・ウエハ	日本、インドネシア、台湾、米国
GlobalWafers	台湾	23	ポリッシュト・ウエハ、エピタキシャル・ウエハ、SOIウエハ	日本、マレーシア、台湾、韓国、イタリア、米国
Siltronic	ドイツ	16	ポリッシュト・ウエハ、エピタキシャル・ウエハ	ドイツ、シンガポール、米国
SK Siltron	韓国	16	ポリッシュト・ウエハ、エピタキシャル・ウエハ	韓国、米国****

出所：各社公表資料を基にUzabase作成

注1：**信越半導体は2020年度（3月期決算）が入手可能な最新データ。売上高のデータは信越化学工業（半導体シリコン部門）のものを示す（同部門は2021年度より信越半導体の電子材料部門に統合された）

注2：***JIW（Junction Isolated Wafer）は埋込層付エピタキシャル・ウエハを指す

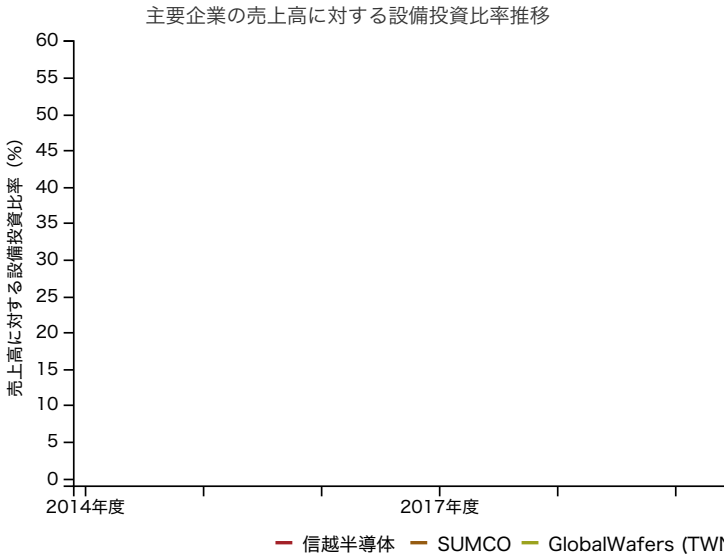
注3：****情報の制約により上表は網羅的ではない場合がある

主要企業は「グリーンフィールド戦略」による生産能力拡大を推進

多額の投資が必要な生産能力拡大は、半導体ウエハメーカーにとっても大きな決断を要する事項である。特に、より小さなプロセスノードなど、需要が変動的に推移する分野向けでは資金調達のハードルも高い。一方、自動車やパワー半導体向け製品を生産する200mmファブからの需要が拡大しており、ウエハ市場では需要が供給を上回るようになった。

既存の生産能力を強化する「ブラウンフィールド戦略」を展開し、費用を抑えながら生産能力を拡大することもできるが、成長が続く需要に十分に応えられない可能性がある。このため、生産能力をゼロから構築する「グリーンフィールド戦略」を採る企業が増えている。このことは、本業界における売上高設備投資比率が2021年以降上昇していることから分かる。ただ、新設備を稼働させるには相当の時間を要するため、短期的には供給不足と価格上昇の局面が続くと考えられる。

これらの生産能力の増強計画は、主に大手チップメーカーとの長期契約によって支えられている。長期契約により、チップメーカーにとってはウエハの安定供給が保証され、ウエハメーカーにとっては安定した需要を確保し、将来の市場状況に応じて価格を管理できるという利点もある。さらに、長期契約には一般的に前払金が必要とされ、これが生産能力増強のための資金となる。たとえば、GlobalWafersでは、前払金は注文総額の約20~30%となっている。



出所：各社公表資料

注1：信越半導体は2020年度（3月期決算）が入手可能な最新データ。データは信越化学工業（半導体シリコン部門）のものを示す（同部門は2021年度より信越半導体の電子材料部門に統合された）

注2：SK Siltronのデータは入手不可

近年のグリーンフィールド投資計画

企業	時期	概要
GlobalWafers（TWN）	2022年6月	・ 2025年までに約50億ドルを投資し、米国に300mmウエハ製造工場を開設する計画 ・ 2024年第4四半期に300mmシリコンウエハの第1バッチを顧客に納品する計画

		<div>・ 320万平方フィートに及ぶ同工場は、この種の工場としては米国最大となる見込み</div> <div>・ 完成後の月産能力は約100万枚の予定</div>
SK Siltron (KOR)	2022年3月	2026年までに約18億ドルを投資し、韓国の300mmウエハ製造工場の技術力を強化する計画
SUMCO	2021年11月	子会社のFormosa Sumco Technology (TWN) を通じて、2024年までに約100億ドルを投資し、台湾に300mmウエハ製造工場を新設する計画
	2021年10月	<div>・ 300mmウエハ生産能力増強のため、約20億ドルを投資する計画</div> <div>・ この大部分については、2025年までに日本に新工場を建設することに集中的に投資予定</div> <div>・ 残りは、ブラウンフィールド（既存の生産工場）の生産能力増強に充てる予定</div>
Siltronic (DEU)	2021年10月	<div>・ 2023年9月にシンガポール経済開発庁との連携のもと建設したシンガポールのウエハ製造工場の操業を開始</div> <div>・ 同社の最先端ウエハ製造施設となる予定</div> <div>・ 単結晶インゴット、ポリッシュト・ウエハ、エピタキシャル・ウエハを生産予定</div>

出所：各社公表資料およびThe Korea Herald、Market Intelligence & Consulting Institute、Electronics Weeklyの情報を基にUzabase作成

信越半導体、SUMCOは技術的競争力が高い

日本に拠点を置く信越半導体とSUMCOは、長年にわたり一貫して最先端技術によりウエハ生産効率を向上してきた。信越半導体は、単結晶の無欠陥化技術やシリコンウエハの高平坦化加工技術を開発している。

一方、SUMCOは、シリコンウエハの開発から製造工程にわたり、ビジネスインテリジェンスやRPA（ロボットによる業務自動化）などのデジタル化ツールを活用しており、2023年には10%超の生産性向上に成功している。

GlobalWafersは無機成長によりSOIウエハ市場でのプレゼンス確立を図る

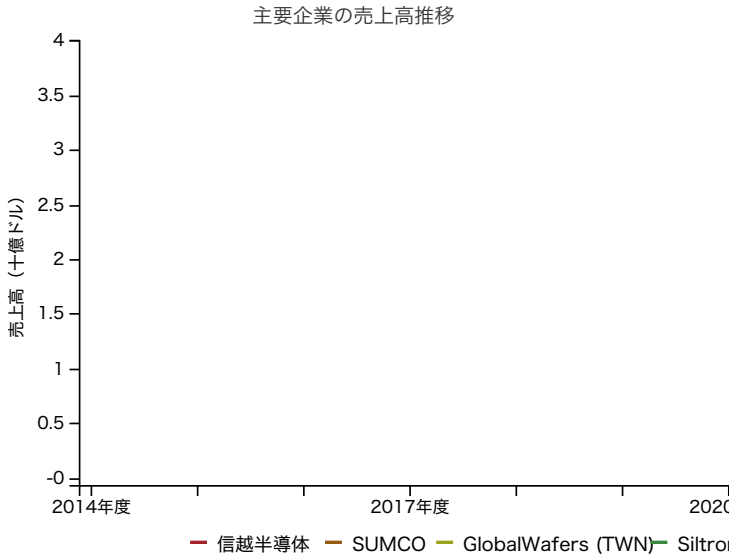
GlobalWafersは、有機的・無機成長戦略の双方をとる会社として知られる。同社は一貫して、自社の製品ポートフォリオと顧客基盤に付加価値を与え補完する企業のみを取引対象とする方針をとっている。2016年12月、シリコンウエハメーカーのSunEdison Semiconductor (USA) を6.83億ドルで買収し、世界第3位のシリコンウエハメーカーとなった。この買収により、SunEdison Semiconductorの優位な市場プレゼンスを活かし、SOI (Silicon-On-Insulator Wafer) ウエハ市場への参入も果たした。

2021年6月には、SOIウエハ市場におけるプレゼンスの確立を目指し、GlobalFoundries (USA) との提携を発表。米国に300mmウエハ製造施設を新設するとともに、既存の200mmウエハ製造施設を拡張する計画である。

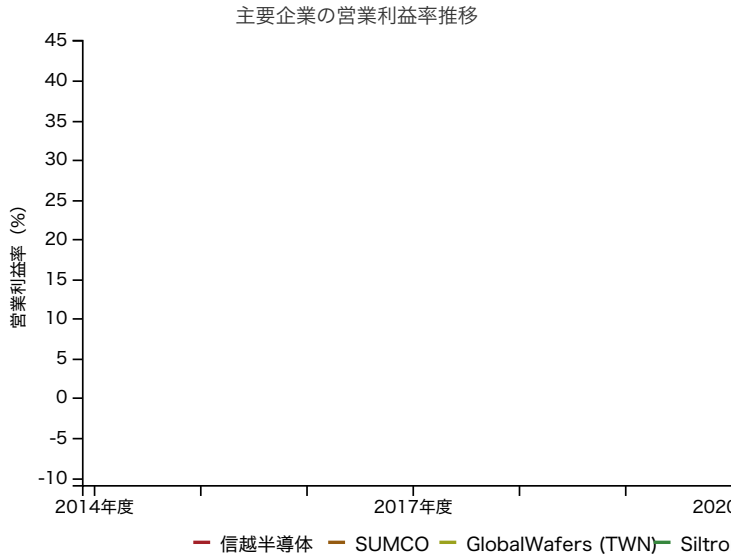
ビッグ5の業績は悪化している

主要企業の売上高は、世界のシリコンウエハ市場売上高を反映している。ビッグ5の売上高は、2020-22年度にかけて堅調な伸びを示したのち、2023年度に軒並み減少した。ビッグ5各社の売上高をみると、2023年度には韓国唯一のシリコンウエハメーカーSK Siltronが前年度比約15%減と最も大幅に減少しており、これにドイツメーカーのSiltronicが同約14%減で続く。Siltronicの減収の主因として、ウエハ販売面積が減少したことが挙げられる。

これに先立ち、2020-22年度にかけてはすべての主要企業が増収を報告した（ただし、信越半導体については2020年度以降のデータは入手不可）。なかでも、Siltronicの売上高はCAGR約17%で増加し、最も高い伸び率を示した。営業利益率は売上高と同様の推移を示し、2020-22年度にかけて上昇したのち、2023年度に低下した。



出所：各社公表資料
注：信越半導体は2020年度（3月期決算）が入手可能な最新データ。データは信越化学工業（半導体シリコン部門）のものを示す（同部門は2021年度より信越半導体の電子材料部門に統合された）



出所：各社公表資料
注：信越半導体は2020年度（3月期決算）が入手可能な最新データ。データは信越化学工業（半導体シリコン部門）のものを示す（同部門は2021年度より信越半導体の電子材料部門に統合された）


業界プレイヤー

全競合企業を見る

対象企業

アナリストによる業界選定のみを表示

(単位：百万円)	決算期	売上高 合計	親会社株 主に帰属す る当期純利 益	親会社株 主に帰属す る当期純利 益率	売上高増 加率	期末従業 員数	時価総額	PER	企業価 値/ EBITDA
 TCL Technology Group Corp	2024/12	3,484,921	33,043	0.9 %	-5.4 %	71,067 人	1,778,191	52.5 倍	10.5 倍
 信越化学工業	2025/03	2,561,249	534,021	20.9 %	6.1 %	27,274 人	8,801,472	16.3 倍	7.2 倍
 Wingtech Technology Co Ltd	2024/12	1,554,793	-59,849	-3.8 %	20.2 %	29,482 人	867,823	N/A	37.9 倍
 SUMCO	2024/12	396,619	19,877	5.0 %	-6.9 %	9,850 人	353,502	17.8 倍	5.8 倍
 Sino-American Silicon Products Inc	2024/12	376,312	25,250	6.7 %	-2.8 %	N/A	292,182	11.4 倍	5.9 倍
 Hua Hong Semiconductor Ltd	2023/12	322,335	38,450	11.9 %	-3.3 %	6,863 人	937,995	24.3 倍	6.6 倍
 GlobalWafers Co Ltd	2024/12	295,775	46,502	15.7 %	-11.4 %	N/A	726,750	15.3 倍	8.9 倍
 Topco Scientific Co., Ltd.	2024/12	269,190	17,267	6.4 %	15.7 %	N/A	253,097	14.4 倍	9.8 倍
 SK SILTRON CO.,LTD. (非上場)	2024/12	236,741	27,679	11.7 %	5.0 %	N/A	N/A	N/A	N/A
 Siltronic AG	2024/12	231,770	10,335	4.5 %	-6.7 %	4,357 人	196,519	18.9 倍	6.2 倍
 SK Siltron Co., Ltd (非上場)	2023/12	218,367	25,225	11.6 %	-14.0 %	N/A	N/A	N/A	N/A
 Soitec SA	2025/03	146,016	15,077	10.3 %	-8.9 %	2,200 人	282,557	18.9 倍	3.8 倍
 三益半導体工業 (非上場)	2024/05	89,109	7,146	8.0 %	-2.0 %	1,186 人	N/A	N/A	N/A
 SILTRONIC SINGAPORE PTE. LTD. (非上場)	2023/12	82,005	12,292	15.0 %	-8.5 %	N/A	N/A	N/A	N/A

	2023/12	79,708	147	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
業界平均	N/A	249,666	17,103	-0.1 %	0.1 %	8,688 人	641,695	204.3 倍	-28.1 倍

- ・ 上記数値は直近株価（直近営業日終値）及び実績値は直近本決算数値を、予想値は会社発表の当期予想を基に計算しております。
- ・ 競合企業は売上高合計順に最大15社まで表示しております。
- ・ デフォルト表示する比較企業の地域（日本企業のみ表示等）は [こちら](#) から変更できます。
- ・ 業界平均の計算はアナリストにより業界選定された企業のみにより計算されております。